

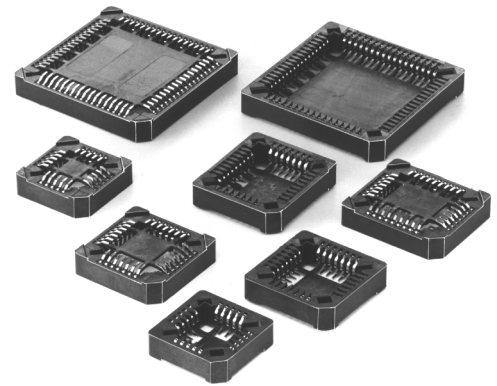
3500

PLCC-Fassung - SMT-Version

PLCC-Socket - SMT Type

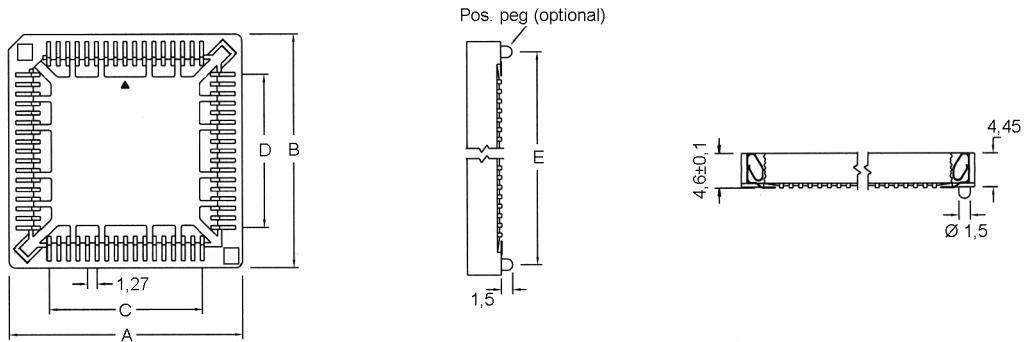
Technische Daten / Technical Data:

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94V0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94V0
Kontaktmaterial	Phosphorbronze
Contact Material	Phosphor Bronze
Kontaktoberfläche	lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3-2,5 µm)
Contact Surface	acc. to options (see below), over Ni (1,3-2,5 µm)
Lötbarkeit	IEC512-12A
Solderability	IEC512-12A
Durchgangswiderstand	≤ 30 mOhm
Contact Resistance	≤ 30 mOhm
Isolationswiderstand	> 10 ⁹ Ohm
Insulation Resistance	> 10 ⁹ Ohm
Spannungsfestigkeit	500 V _{RMS}
Test Voltage	500 V _{RMS}
Nennstrom	1 A
Current Rating	1 A
Temperaturbereich	-55°C...+105°C
Temperature Range	-55°C...+105°C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren; weitere Informationen in Kapitel T
Processing	Reflow-Soldering, further informations in chapter T

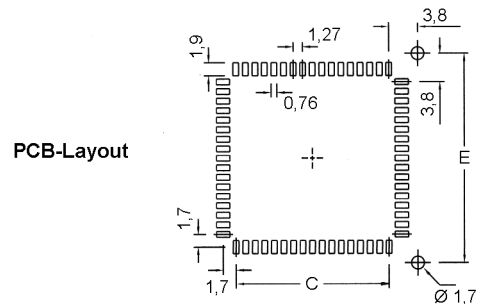


© W+P PRODUCTS

D



Dimensions (mm)					
No. of Contacts	A	B	C	D	E
	± 0,1	± 0,1	± 0,1	± 0,1	± 0,1
20	15,66	15,66	5,08	5,08	12,70
28	18,20	18,20	7,62	7,62	15,24
32	18,20	20,74	7,62	10,16	17,78
44	23,28	23,28	12,70	12,70	20,32
52	25,83	25,82	15,24	15,24	22,86
68	30,90	30,90	20,32	20,32	27,94
84	35,98	35,98	25,40	25,40	33,02



Series	Contacts*	Plating	Positioning Peg*	Packing*	Colour*
3500	32	50	0	ST	1
	20/28/32/44/52/68/84	50 = verzinkt tin plated	0 = ohne Positionierhilfe w/o positioning peg 1 = mit Positionierhilfe w/ positioning peg	ST TR	1 = schwarz black 2 = braun brown

Lieferformen / Packing Options:
 ST = verpackt in Stangen / packed in tubes
 TR = Tape & Reel Verpackung / Tape & Reel Packing

(* Bestellbeispiel - Bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
 * Order example - To be replaced by your specifications.)

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow-Soldering Informations

Reflow-Lötverfahren Reflow-Soldering

Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Lötten im Reflowverfahren verarbeitet werden (Maximalwerte):

Profil Eigenschaft	Bleifreies Lötten
Durchschnitts-Ramp-Up Rate ($T_{s_{max}}$ to T_p)	3 °C / Sek. Max.
Vorheizen - Temperatur Min ($T_{s_{min}}$) - Temperatur Max ($T_{s_{max}}$) - Zeit ($t_{s_{min}}$ auf $t_{s_{max}}$)	150°C 200°C 60-180 Sekunden
Verbleiben oberhalb: - Temperatur (T_L) - Zeit (t_L)	217°C 60-150 Sekunden
Peak/Klassifizierung Temperatur (T_p)	260°C +/- 5°C
Zeit innerhalb von 5°C um die Peak-Temperatur (t_p)	20-40 Sekunden
Ramp-Down Rate	6°C / Sekunde max.
Zeit von 25°C bis zur Peak-Temperatur	8 Minuten max.

© W+P PRODUCTS

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature-profile for leadfree reflow-soldering (maximum values):

Profile Feature	PB-Free assembly
Average Ramp-Up Rate ($T_{s_{max}}$ to T_p)	3 °C / second max.
Preheat - Temperature Min ($T_{s_{min}}$) - Temperature Max ($T_{s_{max}}$) - Time ($t_{s_{min}}$ to $t_{s_{max}}$)	150°C 200°C 60-180 seconds
Time maintained above: - Temperature (T_L) - Time (t_L)	217°C 60-150 seconds
Peak/Classification Temperature (T_p)	260°C +/- 5°C
Time within 5°C of actual Peak Temperature (t_p)	20-40 seconds
Ramp-Down Rate	6°C / second max.
Time 25°C to Peak Temperature	8 minutes max.

Empfohlenes Reflow-Lötprofil:

Recommended Reflow-Soldering profile:



T